

## 第7回ユニーク・自作チップ・コンテスト 前回からの変更点

以下の点について、今回から変更となりますので、ご注意ください。

### 1. パッケージング方法の変更

- 前回までは、ウェハプロセスと簡単な測定作業までを参加者に行っていただき、パッケージングは、外部の専門業者に委託していました。
- 今回からは、パッケージングも、コンテストの会場である「共同研究開発センター」で行い、コンテストに参加された方々にも、パッケージング作業の一部を行っていただくこととしました。但し、このパッケージング作業への参加は任意とし、作業に参加できない方のチップのパッケージングはスタッフが行います。
- チップは、樹脂モールドされた LQFP64pin から、セラミックパッケージ（DIP48pin）に変更となります。

### 2. 前記1.に伴う変更

- 参加者に使用いただける pin 数は、これまでの 52pin から 48pin になります。
- お送りするチップの個数は、今回からは 3 個～5 個となります。

以上